

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年8月4日(04.08.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/163701 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *H05K 3/28* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/002892
- (22) 国際出願日: 2022年1月26日(26.01.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-012245 2021年1月28日(28.01.2021) JP
- (71) 出願人: 太陽インキ製造株式会社(TAIYO INK MFG. CO., LTD.) [JP/JP]; 〒3550215 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤900番地 Saitama (JP).
- (72) 発明者: 間中 薫(MANAKA Kaoru); 〒3550215 埼玉県比企郡嵐山町大字平澤900番地 太陽インキ製造株式会社内 Saitama (JP).
- (74) 代理人: 中村 行孝, 外(NAKAMURA Yukitaka et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命丸の内ビル 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PRINTED WIRING BOARD MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物およびプリント配線板の製造方法

(57) Abstract: [Problem] To provide a photosensitive resin composition that has, even when being adjusted to have a low viscosity, excellent developing properties and ability to cover edge portions of a circuit of a printed wiring board when being applied. [Means] The photosensitive resin composition according to the present invention is characterized by containing a carboxyl group-containing resin, a thermosetting resin, a photosensitive monomer, and an organic solvent, and is characterized in that, when the viscosity of the photosensitive resin composition at 25°C is defined as A (dPa·s) and the volume resistivity value of the photosensitive resin composition at 25°C is defined as B (MΩ) and when the viscosity of the photosensitive resin composition is adjusted to A₁=5.0 (dPa·s) and A₂=1.5 (dPa·s) by using propylene glycol monomethyl ether, B₁ (MΩ) that represents the volume resistivity value at A₁ and B₂ (MΩ) that represents the volume resistivity value at A₂ satisfy formula: 1.4≤(A₁-A₂)/(B₁-B₂)≤40.

(57) 要約: [課題] 低粘度に調整した場合でも塗布時のプリント配線板の回路のエッジ部分へのカバーリング性と現像性に優れる感光性樹脂組成物の提供。[手段] 本発明による感光性樹脂組成物は、カルボキシル基含有樹脂、熱硬化性樹脂、感光性モノマー、および有機溶剤を含み、前記感光性樹脂組成物の25℃における粘度をA (dPa·s) とし、前記感光性樹脂組成物の25℃における体積固有抵抗値をB (MΩ) とすると、プロピレングリコールモノメチルエーテルを用いて前記感光性樹脂組成物の粘度をA₁=5.0 (dPa·s)、A₂=1.5 (dPa·s) に調整した時、A₁の時の体積固有抵抗値をB₁ (MΩ)、A₂の時の体積固有抵抗値をB₂ (MΩ) が、下記式: 1.4≤(A₁-A₂)/(B₁-B₂)≤40 を満たすことを特徴とする。

WO 2022/163701 A1